



2023年3月20日

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 倉 嶋 進
コード番号 6967 東証プライム市場
問 合 せ 先 経営企画室長 清 野 貴 博
TEL (026) 283-1000 (代)

当社の親会社 富士通株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 時 田 隆 仁
コード番号 6702 東証プライム市場

業績予想の修正に関するお知らせ

業績予想の修正につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2023年3月期通期連結業績予想数値の修正（2022年4月1日～2023年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	322,000	93,000	97,000	67,000	495.92
今 回 修 正 予 想 (B)	283,000	75,000	77,000	53,000	392.30
増 減 額 (B-A)	△39,000	△18,000	△20,000	△14,000	—
増 減 率 (%)	△12.1	△19.4	△20.6	△20.9	—
(ご参考) 前期実績 (2022年3月期)	271,949	71,394	75,820	52,628	389.58

2. 修正の理由

半導体市場は、世界的な景気減速やコロナ特需の反動等を背景とするパソコン、スマートフォンの需要減退や在庫調整の長期化に加え、データセンター向けの投資抑制等の影響を受けるなど、第4四半期に入り半導体市況の減速傾向がさらに強まる状況となりました。

このような状況下において、当社グループにおきましては、市況減速の影響を大きく受け、第4四半期における各製品の売上は想定に比べ総じて下回って推移しております。

フリップチップタイプパッケージは、パソコン向けに加え、サーバー向けのパッケージ需要減退の影響を大きく受け、売上が想定を下回る見込みです。半導体製造装置向けセラミック静電チャックは半導体輸出規制等を背景として出荷台数が減少し、リードフレームは在庫調整の影響を受け、また、IC組立はスマートフォンの需要低迷により受注が減少するなど、売上高は想定を下回る見込みとなりました。利益面につきましても、売上高の減少により想定を下回る見込みとなりました。

このような状況をふまえ、2022年7月29日に発表いたしました2023年3月期通期の連結業績予想数値を修正いたします。

なお、上記予想値は第4四半期の為替レートを1米ドル=130円にて算出しております。

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以 上